

# DIN 6113-1:2010-08 (D)

## Verpackung - Elektronische Identifikation von starren Industrieverpackungen, Positionierung und Systemparameter für passive RFID-Chips - Teil 1: Allgemeines

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Begriffe .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>RFID-Chipplatzierung an starren Industrieverpackungen .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Technische Anforderungen an RFID-Chips und Lesegerät .....</b>	<b>5</b>
<b>5.1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2</b>	<b>Elektronische Anforderungen an RFID-Chips und Lesegerät .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2.2</b>	<b>RFID-Chip .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2.3</b>	<b>RFID-Chiplesegerät .....</b>	<b>5</b>
<b>5.3</b>	<b>Struktur der Nutzdaten.....</b>	<b>6</b>